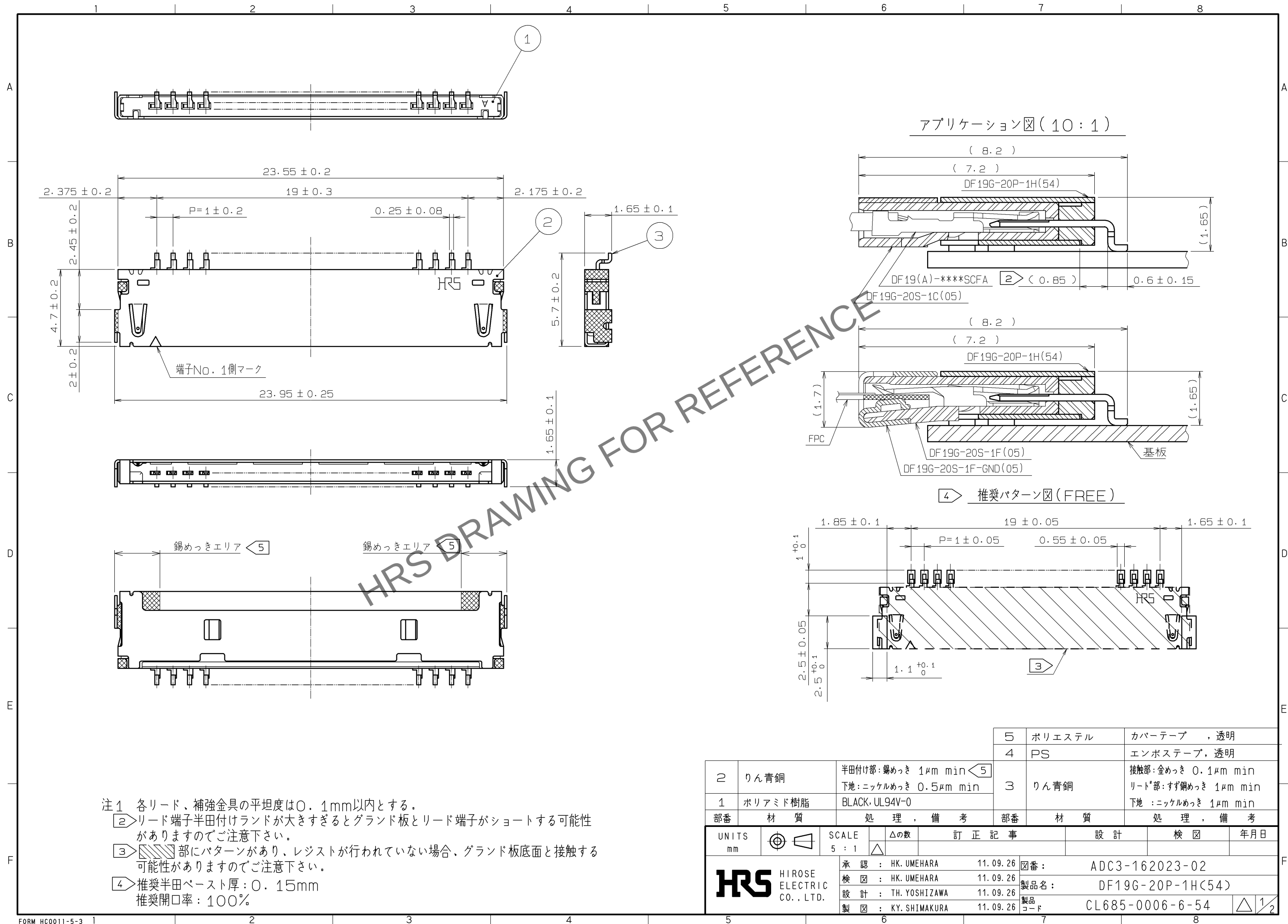
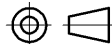




注1 各リード、補強金具の平坦度は0.1mm以内とする。
② リード端子半田付けランドが大きすぎるとグラウンド板とリード端子がショートする可能性がありますのでご注意下さい。
③ 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、グラウンド板底面と接触する可能性がありますのでご注意下さい。
④ 推奨半田ペースト厚: 0.15mm
推奨開口率: 100%

			5	ポリエステル	カバーテープ , 透明			
			4	PS	エンボステープ , 透明			
2	りん青銅	半田付け部: 錫めっき 1μm min 5 下地: ニッケルめっき 0.5μm min	3	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min リード部: すず銅めっき 1μm min 下地 : ニッケルめっき 1μm min			
1	ポリアミド樹脂	BLACK: UL94V-0						
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考			
UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			承 認 : HK. UMEHARA 11.09.26		図番: ADC3-162023-02			
			検 図 : HK. UMEHARA 11.09.26		製品名: DF19G-20P-1H(54)			
			設 計 : TH. YOSHIZAWA 11.09.26		製品コード: CL685-0006-6-54			
			製 図 : KY. SHIMAKURA 11.09.26					
								1/2

